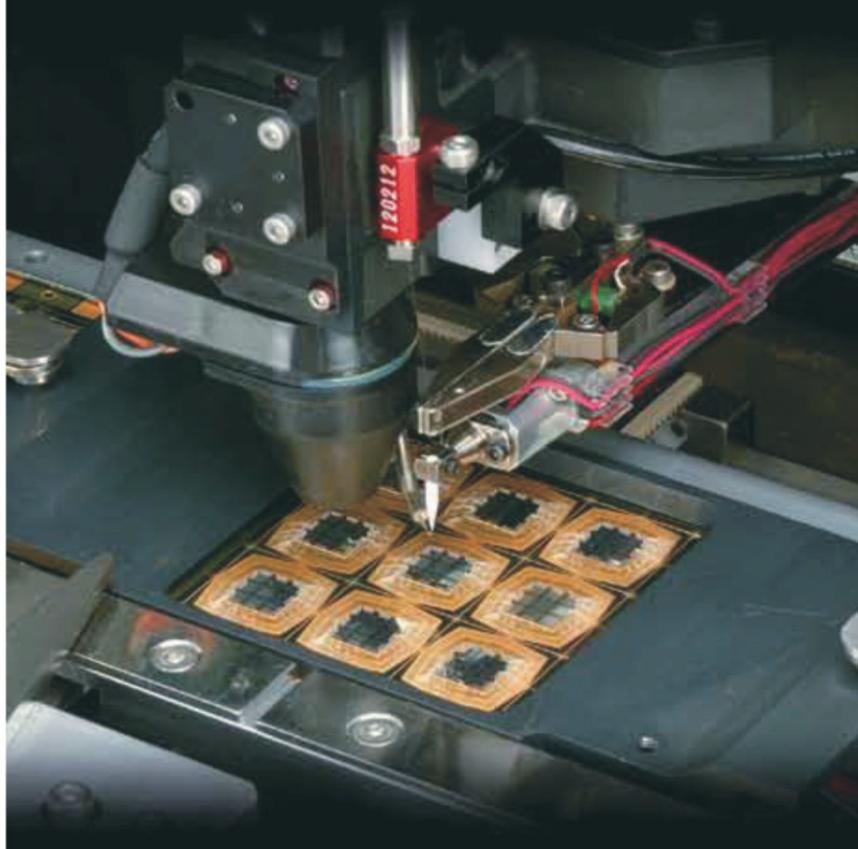


KAIJO®

FB-996 *New*

面向大型IC产品的生产需求
可对应超大的焊线范围(Y:95mm)

*Wide bonding area (Y:95mm)
capable of large IC device production*



FB-996 的特点

- * 扩大了焊线范围 (Y:95mm)
 - 可对应大型IC产品的生产需求
- * 通过新开发的高刚性・超轻型焊头，达到超高的精度以及超低的冲击压力
 - 使用复合材料制成的焊线摆臂
 - 超小型超轻型1701型迷你振动子
 - 搭载高速接触检测功能
- * 对应合金线 (Ag/Cu) 焊接 (选配)
- * 全新Windows界面・舒适的新型操作环境

Features of FB-996

- * Wide bonding area (Y:95mm)
 - Capable of large IC device production
- * New bonding head, rigid and lightweight satisfies high accurate bonding performance and low impact load to boards
 - Composite bonding arm
 - 1701 lightweight mini-horn
 - High speed touch detector
- * Capable of alloy wire (Ag/Cu) bonding optionally
- * User friendly new operational environment by Windows

FB-996

Wide bonding area (Y:95mm)
capable of large IC device production

■ 主要规格

焊线性能	
重复焊线精度 (不包含自身编辑精度)	$\pm 2.5 \mu\text{m}$ (3 σ) ※根据对应品种需要精度稳定化
焊线范围	56mm × 95mm
图像识别系统	高速・高精度图像处理引擎 1/3" CCD摄像机 2.1/6倍镜头
线弧特性 (使用线径为25 μm)	
线长	最大8.0mm
弧高	标准模式/100 μm FJ线弧/65 μm
弧度	线长的1%以下
焊线能力	
焊线速度	50msec/线
图像识别时间	100msec/2点 (□5mm 芯片时)
Lead识别时间	11msec/Lead (监控器内有3个支架的情况)
搬送系统	
支架的尺寸	宽度 : 30mm~105mm
	长度 : 90mm~295mm
	厚度 : 0.1mm~0.5mm
料盒	宽度 : 30mm~115mm
	长度 : 95mm~300mm
	高度 : 100mm~175mm
	存放数量 : 2~3个料盒
操作性	
显示器	19.5"彩色显示器
操作面板	持久耐用的专用开关 附带3个按钮鼠标操作
外部通讯	
	HSMS标准配置
	USB存储器
应用条件	
干燥压缩空气	0.3~0.97MPa (3.1~9.9Kgf/cm ²) 35NL/min
真空	-53.32KPa以下 (400mm/Hg以上)
供电电压	AC200V、50/60Hz、 $\pm 5\%$ 以下 (AC210、220、230、240V可选择)
消耗电力	瞬间功率1.5KVA 连续运转时0.8KVA
外观尺寸	W780 × D1085 × H1729mm (包括信号灯H2010mm)
重量	550kg

■ SPECIFICATIONS

Bonding	
Repeatability of Bonding Accuracy (Excluding Self-Teach Accuracy)	$\pm 2.5 \mu\text{m}$ (3 σ) ※Special kit for accuracy stability may be required depending on devices.
Bonding Area	56mm × 95mm
Recognition System	High Speed・High Accuracy Process Engine 1/3"CCD Camera 2.1 and 6 magnification lens
Looping (In the case of wire diameter 25 μm)	
Wire Length	8.0mm in max
Loop Height	Standard mode 100 μm FJ Loop 65 μm
Wire Curl	Less than 1% of the wire length
Productivity	
Bonding Time	50msec/wire
Recognition Time	100msec/2 points (□5mm Chip)
Lead Locate(VLL)Time	11msec/lead (In the case of 3 leads within a monitor)
Indexing System	
Package Frame Size	Width : 30mm~105mm
	Length : 90mm~295mm
	Thickness : 0.1mm~0.5mm
Magazine	Width : 30mm~115mm
	Length : 95mm~300mm
	Height : 100mm~175mm
	No.of Stock : 2~3 Magazines
Operability	
Monitor	19.5"color Wide LCD
Operation Panel	Operation by mouse with 3 buttons
External Interface	
	HSMS
	USB memory
Utility	
Air	0.3~0.97MPa (3.1~9.9Kgf/cm ²) 35NL/min
Vacuum	-53.32KPa or less (400mm/Hg or more)
Power Source	AC200V、50/60Hz、 $\pm 5\%$ or less (AC210、220、230、240V option)
Power Consumption	Peak 1.5KVA Sequential operation 0.8KVA (Kaijo standard carrier)
Overall Dimensions	W780 × D1085 × H1729mm (H2010mm, including indicating lamp)
Weight	550kg

⚠ 安全注意事项: 为了安全使用产品, 使用前请仔细阅读操作说明书。

●目录上的注意点... 目录上所刊载商品的规格以及外观如有所改良恕不另行通知, 请知悉。

⚠ CAUTION FOR SAFE: Please read surely INSTRUCTION MANUAL before operate.

●Specification is subject to change without prior notice for improvement.



株式会社 カイジョー / KAIJO CORPORATION URL <https://www.kaijo.co.jp>
東京都羽村市栄町 3-1-5 〒 205-8607 TEL 042-555-2244



深圳汉华半导体科技有限公司
Shenzhen Hanhwa Semiconductor Technology Co., Limited

地址: 深圳市宝安区松岗街道潭头社区恒生工业园第四栋
电话: 0755-8524 0596 传真: 0755-2300 1062
邮箱: chenyp@hanhwachina.cn
网站: www.hanhwachina.cn

